

【東京/武蔵村山】機械設計（半導体製造装置）　◆ヤマハ発動機グループ

ヤマハロボティクス株式会社での募集です。 機械設計・機構設計・筐体設計・メカト...

募集職種

人材紹介会社
株式会社ジェイ エイ シー リクルートメント

採用企業名
ヤマハロボティクス株式会社

求人ID
1594517

業種
電気・電子・半導体

雇用形態
正社員

勤務地
その他東京

給与
450万円 ~ 750万円

勤務時間
08:45 ~ 17:30

休日・休暇
【有給休暇】有給休暇は入社後4ヶ月目から付与されます 初年度 採用月に応じて2日 ~ 15日 4か月目から 【休日】完全週休二日制...

更新日
2026年11月15日 09:00

応募必要条件

キャリアレベル
中途経験者レベル

英語レベル
無し

日本語レベル
ネイティブレベル

最終学歴
専門学校卒

現在のビザ
日本での就労許可が必要です

募集要項

【求人No NJB2335265】

MISSION
半導体製造装置（ボンディング装置）メーカーである同社において、
機械設計職の募集です。

[取扱い製品]
ワイヤボンダ、ダイボンダ、バンプボンダ、フリップチップボンダ、等

半導体製造装置の新機種開発、カスタマイズ設計をご担当いただきます。
顧客要望のヒアリングから仕様検討、設計、出図業務、試運転立ち合いまで一貫してかかわることができるのが魅力です。

※残業想定時間：20時間程度を想定

■半導体ボンディング装置のパイオニア企業

1970年代後半、それまで人の手で行われていたワイヤボンディング（半導体製造における後工程作業）の全自動化に成功したのは当社です。競合が増えた今、当社の強みは品質No.1であり仕様に沿ってカスタマイズ設計ができること。この丁寧さは今後も捨てずに、日本企業としての自信・自負をもって世界No.1であり続けるのが私たちの目標です。

□主力製品「フリップチップボンダ」について

半導体製造のための精密ロボットです。
ウェハー上に形成された半導体素子を、反転（フリップ）させて基板上
もしくはウェハー上へボンディングする為の装置で、従来のワイヤボンディングに
替わる新しい実装技術になります。
最新のスマートフォンやデータセンタの中心的な役割を果たすICを
製造する為の装置です。
メカトロニクス技術はもちろん、制振制御、ロボティクス、材料工学、
画像処理技術などあらゆる最先端の技術がつまっています。

スキル・資格

【必須条件】
・機械装置、産業機器の設計や駆動系開発のご経験

会社説明

ヤマハロボティクス株式会社（Yamaha Robotics Co. Ltd.）は、ヤマハ発動機株式会社グループにおいて半導体製造装置（後工程）および電子部品組み立て装置事業を担う会社です。